

2023年10月31日

台湾における研究開発施設の設置について

富士紡ホールディングス株式会社（以下、当社）は、主力の研磨材事業の拡大に向けて、当社連結子会社である台湾富士紡精密材料股份有限公司に、最先端の研究開発施設を新たに設置いたします。

1. 施設概要

(1) 名称	台湾富士紡精密材料股份有限公司 研究開発センター（仮称）
(2) 所在	台湾新竹市周辺を予定
(3) 設置目的	研磨材等の開発
(4) 投資総額	約5.7億円（注）
(5) 稼働開始予定	2026年秋頃

（注）現時点の予定であり、土地・施設設置に係るスキームの変更に応じて変動する可能性があります。

2. 目的

半導体市場は、5G・6Gによる通信の高速化・大容量化、AI・メタバース・IOTの普及等に伴って、2030年には、現状比約2倍の100兆円規模への市場成長（注1）と高性能化が見込まれています。

当社は、半導体デバイス製造工程に使用する超精密加工用研磨材製品を展開しており、微細化が進展する半導体デバイスのCMP（注2）用途の拡大に向けて、最先端の半導体関連企業が集積する台湾に、研究開発施設を設置することといたしました。

施設内に研磨装置・評価機器等を設置して、顧客とほぼ同等のCMP環境を実現、顧客要望にきめ細かく対応して、高性能・高品質の研磨材製品開発を推進します。

（注1） 当社調べ

（注2） Chemical Mechanical Polishing（化学的機械研磨）

3. 今後の見通し

本件による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上